

<<微机电系统封装>>

图书基本信息

书名：<<微机电系统封装>>

13位ISBN编号：9787302119524

10位ISBN编号：730211952X

出版时间：2006-1

出版时间：清华大学出版社

作者：徐泰然

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<微机电系统封装>>

### 内容概要

本书针对来自工业界、研究实验室和大学的工程师、科学家以及技术人员编写，对微机电系统和微系统的组装、封装与测试各个方面进行了分析，内容涉及从基本实用技术到生命科学、电信以及航空工程等重要领域的许多应用。

本书覆盖了许多关键的领域，例如微元件的键合与密封、微机电系统和微系统的过程流程、自动微组装过程、射频通信以及航空应用等。

对工作在微机电系统和微系统领域的工程师和技术人员有重要参考价值。

<<微机电系统封装>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>